



2017.03.14

TAIEX : 8070

CWE Commit to Total Excellence

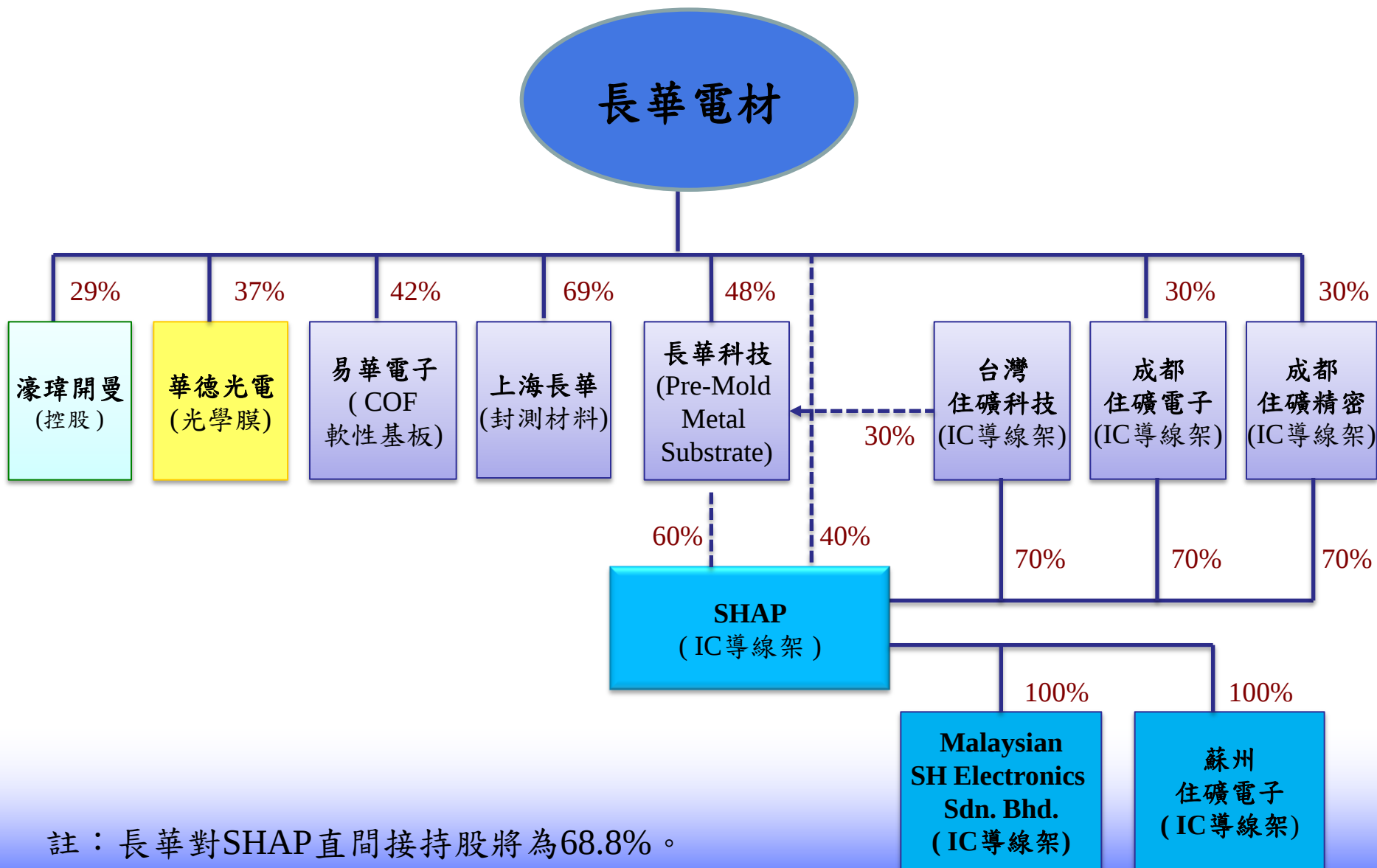
大綱

- 一、公司簡介
- 二、營運績效
- 三、重要轉投資公司
- 四、MLB專案暨購併SHAP綜效
- 五、全球半導體封裝材料趨勢
- 六、集團之策略佈局與發展規劃

一、公司簡介

設立日期	1989年5月13日
董事長	黃嘉能
總經理	葉錕溢
實收資本額	新台幣6.39億元
員工人數	88人(單一) 253人(合併)
總公司地址	高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓

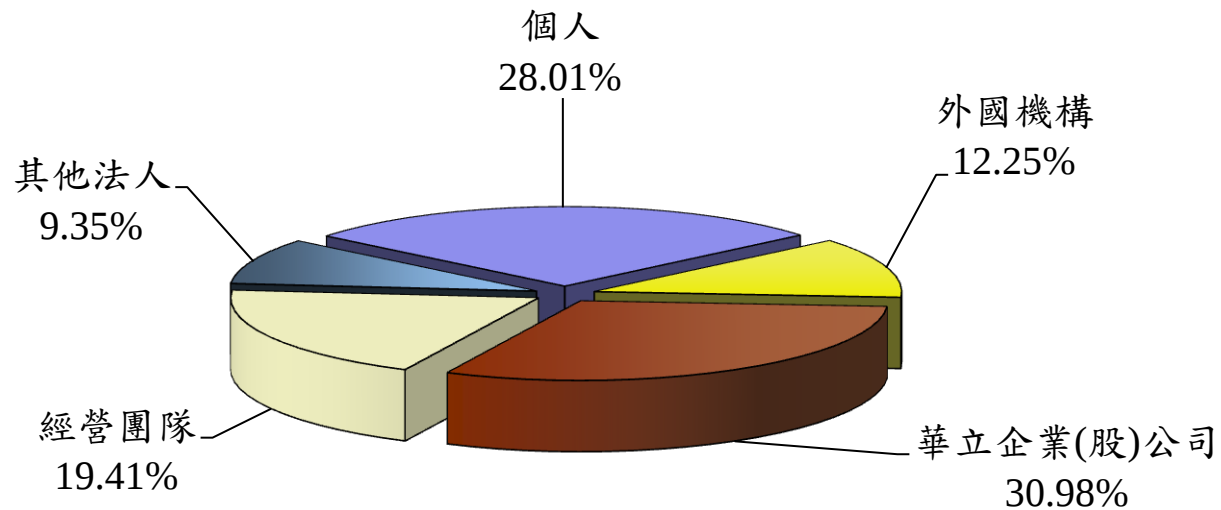
主要轉投資架構圖



註：長華對SHAP直間接持股將為68.8%。

產業別	主要商品	國內市場佔有率
IC封裝材料代理	封膠樹脂 (EME)	64%
	導電膠(銀膠)及非導電膠 (CRM)	37%
	導線架 (Lead Frame)	30%
	自動模壓設備 (Auto Molding Equipment)	35%
	去渣成型設備 (Trim & Form Equipment)	80%
IC封裝基板製造	Metal Substrate (Premold)	? %
	Organic Substrate	? %

股東結構(2016.06)



二、營運績效

2016年營運績效(合併)



單位：NTD百萬元	2016年		2015年		變動率
	金額	%	金額	%	%
營業收入	10,942	100.0	15,080	100.0	(27.4)
銷貨成本	9,978	91.2	13,583	90.1	(26.5)
營業毛利	963	8.8	1,497	9.9	(35.7)
營業費用	600	5.5	1,173	7.8	(48.9)
營業利益	364	3.3	325	2.2	12.1
營業外收入及支出	651	5.9	994	6.6	(34.5)
繼續營業單位稅前淨利	1,014	9.3	1,319	8.7	(23.1)
所得稅費用	175	1.6	144	1.0	21.5
繼續營業單位本期淨利	840	7.7	1,175	7.8	(28.5)
停業單位損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	-
本期淨利	840	7.7	1,175	10.7	(28.5)
淨利歸屬於本公司業主	786		1,027		(23.5)
淨利歸屬於非控制權益	54		147		(63.4)
每股盈餘(元)-稅後	11.37		13.57		

*每股盈餘分別以2016年、2015年流通在外股數69,249股、76,045仟股計算。

2012~2016年資產負債表摘要(合併)



單位：NTD百萬元	2012.12.31 (IFRSs)	2013.12.31 (IFRSs)	2014.12.31 (IFRSs)	2015.12.31 (IFRSs)	2016.12.31 (IFRSs)
現金及短期投資	1,509	1,144	1,241	1,427	1,302
應收帳款	4,130	4,778	4,925	4,294	2,598
流動資產	7,267	7,746	8,441	7,828	5,262
長期投資	735	1,116	1,125	2,408	3,178
流動負債	4,781	5,211	5,658	5,038	2,938
長期負債	1,096	1,417	2,184	1,972	400
權益總計	4,562	5,632	6,257	6,721	5,867
總資產	10,680	12,482	14,340	13,966	9,438
每股淨值(元)	53.93	56.15	59.30	67.31	81.83
流動比率	152%	149%	149%	155%	179%
負債比率	57%	55%	56%	52%	38%

歷年獲利及股利



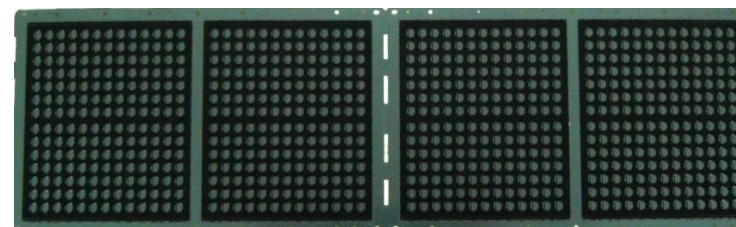
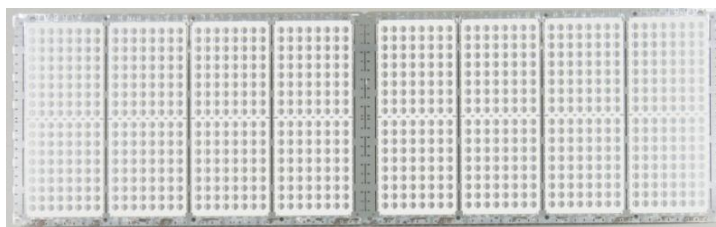
新台幣：元	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
稅後EPS	7.06	14.00	0.29	9.34	5.89	5.29	13.57	11.37
股票股利	0.00	0.30	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
現金股利	6.00	9.70	0.60	3.00	3.10	3.50	7.00	10.00
合計股利	6.00	10.00	0.89	3.30	3.10	3.50	7.00	10.00
股利發放率	85%	71%	307%	35%	53%	66%	52%	88%

三、重要轉投資公司

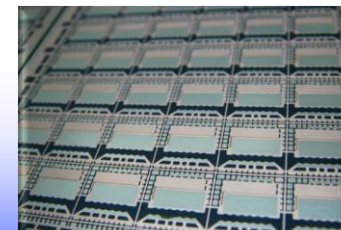
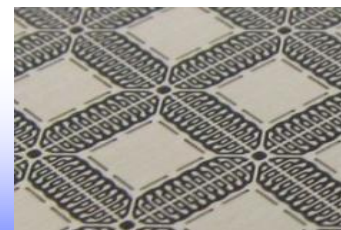
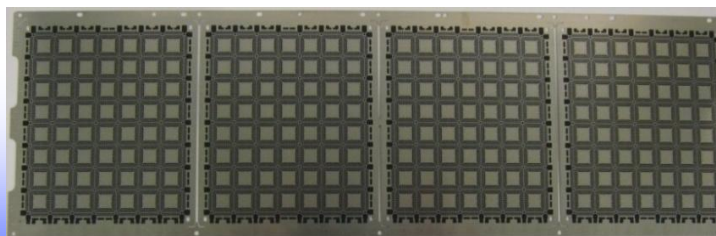
設立日期	2009年12月24日
董事長	黃嘉能
總經理	溫文郁
實收資本額	新台幣2.46億元(增資後3.01億元)
員工人數	139人
主要產品	Pre-Mold Metal Substrate
轉投資	長科實業(上海)有限公司
總公司/工廠	高雄市楠梓加工出口區

年度	2009~2012	2012~2016	2017~
主要產品	LED PPA 導線架	LED EMC 導線架	IC金屬導線架
			Pre-Mold Metal Substrate
			LED EMC導線架

LED



IC



品項	產品應用	終端應用
LED EMC導線架	LCD顯示器背光模組 照明模組	LCD TV 戶外看板 室內外照明
Metal Substrate (QFP、SOP/TSSOP、SOT、 QFN/SON)	IC 封裝金屬載板	通訊IC 汽車IC 3C電子IC 記憶體IC 航太科技IC 車用IC(自動駕駛) 工業用IC 醫療用IC (高可靠度、耐候型IC封裝)
Pre-Mold Metal Substrate (QFN、DFN..)		

目標客戶

- OSATs (長華現有客戶)
- IDM、OSATs (S.H.M導線架客戶)
- China Local Customer(新開發)

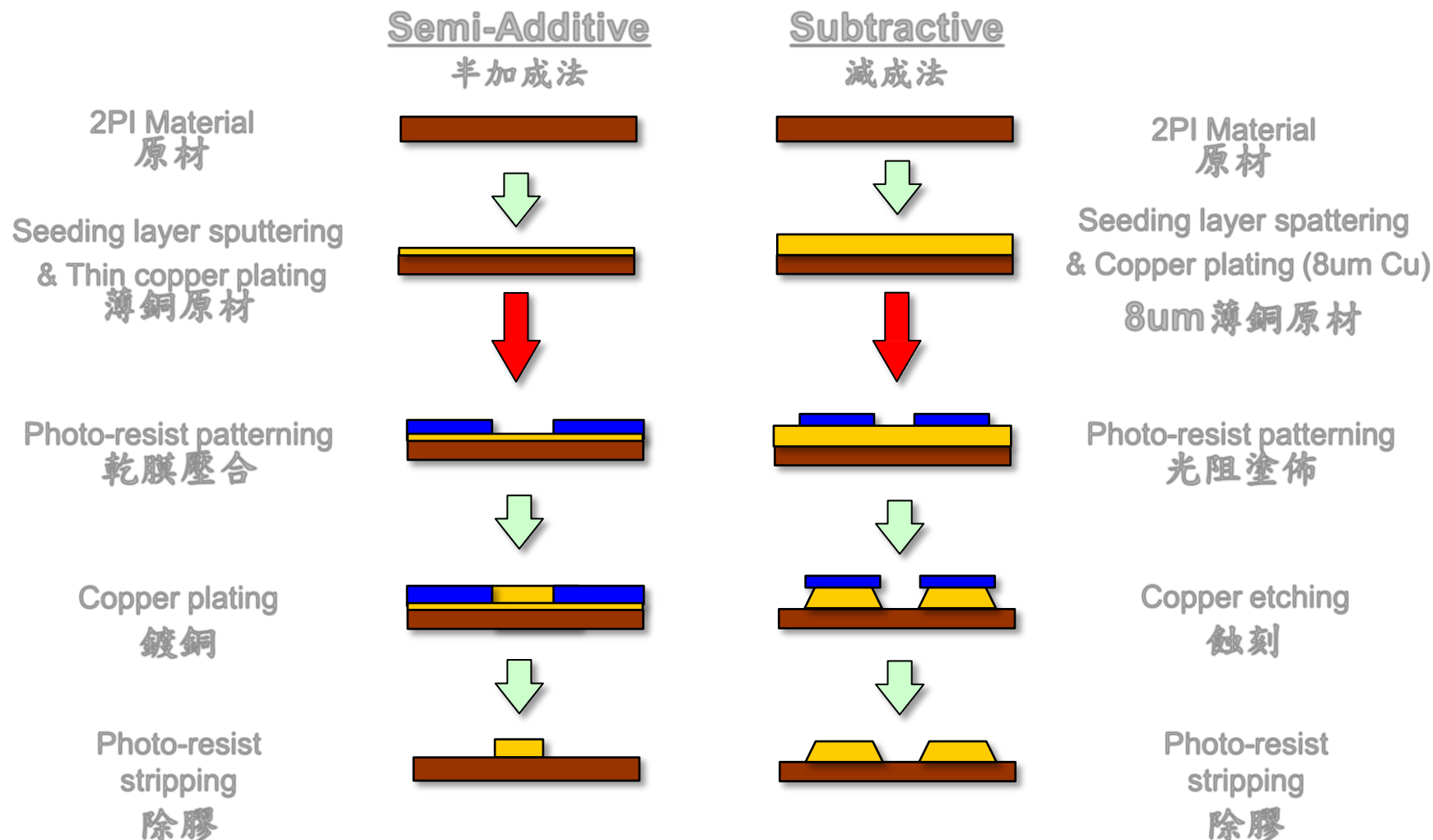
CWTC 損益表



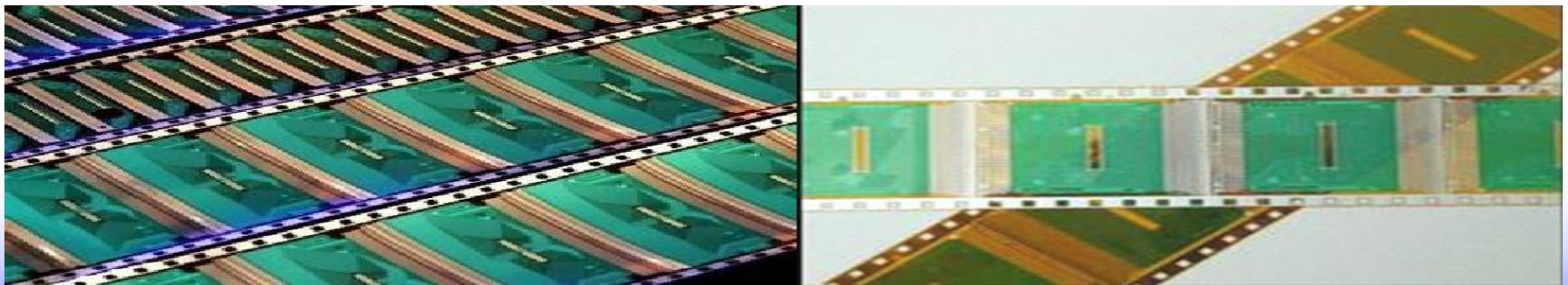
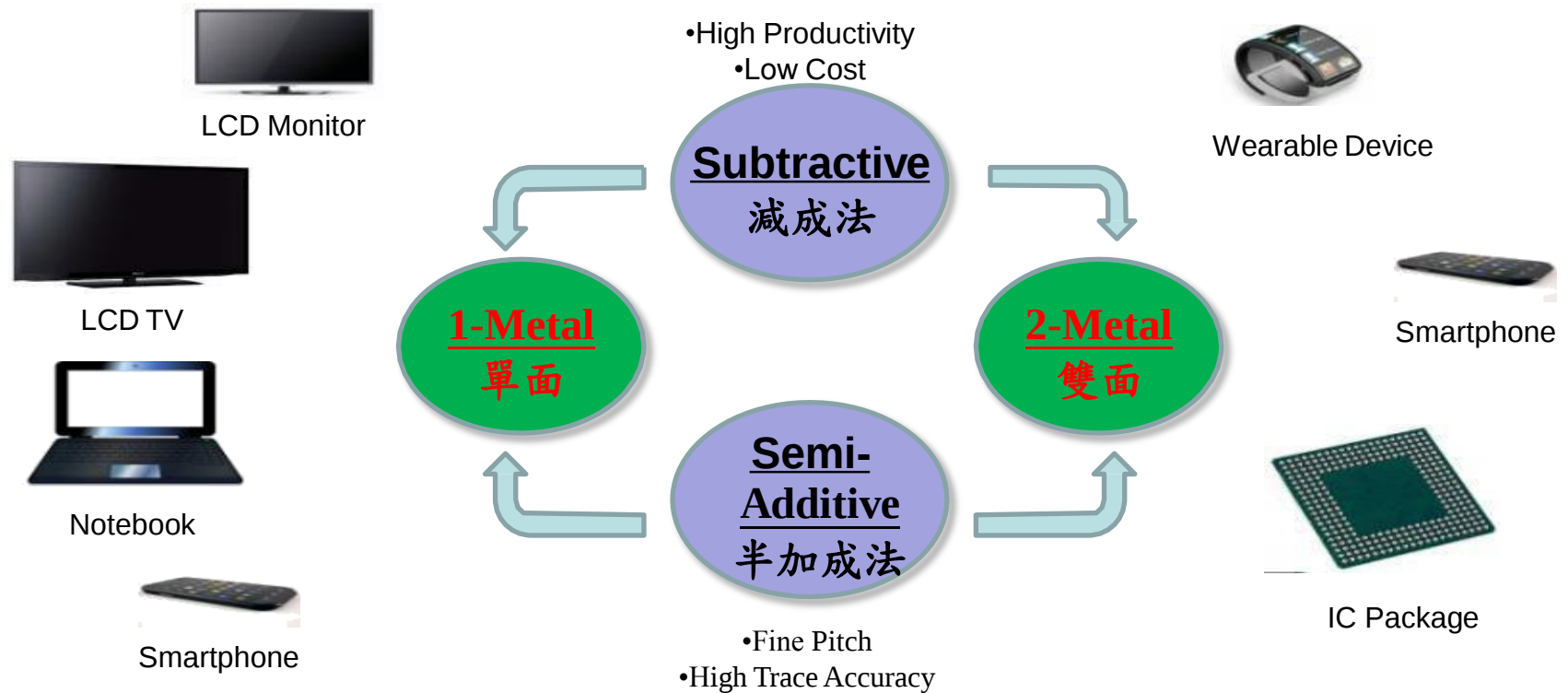
單位:新台幣仟元

年度 項目	102年	103年	104年	105/1~3Q
營業收入	343,247	393,939	378,404	346,235
營業毛利	73,689	131,804	116,664	107,011
毛利率	21.47%	33.46%	30.83%	30.91%
營業利益	49,774	74,453	62,320	50,913
稅前淨利	25,979	74,399	75,945	40,763
稅後淨利	21,532	62,644	58,508	34,296
基本每股盈餘(元)	1.6	4.09	2.66	1.55
已發行股數(千股)	15,206	22,006	22,006	24,505

設立日期	1973年10月6日(原名台灣住礦電子股份有限公司) 2014年 4月1日(更名為易華電子股份有限公司)
董事長	黃嘉能
總經理	李宛霞
實收資本額	新台幣10億元
員工人數	547人
主要產品	捲帶式高階覆晶薄膜IC基板 (Reel to Reel Chip on Film)
總公司/工廠	高雄市楠梓加工出口區



JMC同時擁有半加成法(Semi-Additive)及減成法(Subtractive)製程技術



JMC 競爭同業比較



製程技術			1-Metal Subtractive (Etching) 單面減成法	1-Metal Semi-Additive (Plating) 單面半加成法	2-Metal 雙面法
應用	Channel (線路)/(帶寬)		<1400 /48mm	1400~1900 /48mm	1900~2500 /48mm
	Channel (線路)/(帶寬)		<2000 /70mm	2000~3000 /70mm	3000~4000 /70mm
產能	韓國	S社	90~100KK		5KK Plating+Etching
		L社	120~130KK		2KK Est. =>2016 Plating+Etching
	日本	F社	20KK		2KK Etching
	台灣	C社	70~90KK		
		JMC	20KK (另有20KK尚未重啟)		5KK=>2017年 Plating+Etching
				36KK	

厚銅COF (12um)

- 高階4K2K TV面板-散熱對策
- 8K4K TV面板-散熱對策

細線路(18um Pitch) & 高腳數(1400 Channel以上)COF

- 高精細畫質面板
- 追求輕薄短小特性
- 軟性面板

2-Metal (雙面)COF

- 軟性面板
- 高階智慧型手機
- 穿戴裝置

2-Metal 的IC Thin Film Substrate

- 記憶體IC
- 邏輯IC

JMC 損益表



單位:新台幣仟元

年度 項目	102年	103年	104年	105年
營業收入	1,526,462	1,261,378	1,588,245	1,667,761
營業毛利	40,255	114,272	409,694	344,810
毛利率	2.64%	9.06%	25.80%	20.68%
營業利益	-4,278	44,282	287,784	184,921
稅前淨利	43,360	52,953	309,037	165,930
稅後淨利	75,550	67,427	284,267	136,303
基本每股盈餘(元)	2.52	1.55	3.22	1.51
已發行股數(千股)	71,000	70,000	90,000	90,000

四、MLB專案 暨 購併SHAP綜效

WORLD WIDE TOP 5 LEADFRAME MARKET SHARE FOR 2014

Supplier	2014 Rank	2014 Revenues US\$ M	2014 % Market Share
SHM	1	357 M(USD)	11.10%
Mitsui High-tec	2	331 M(USD)	10.30%
Shinko Electric	3	282 M(USD)	8.80%
SDI	4	271 M(USD)	7.60%
ASM Pacific	5	245 M(USD)	5.60%

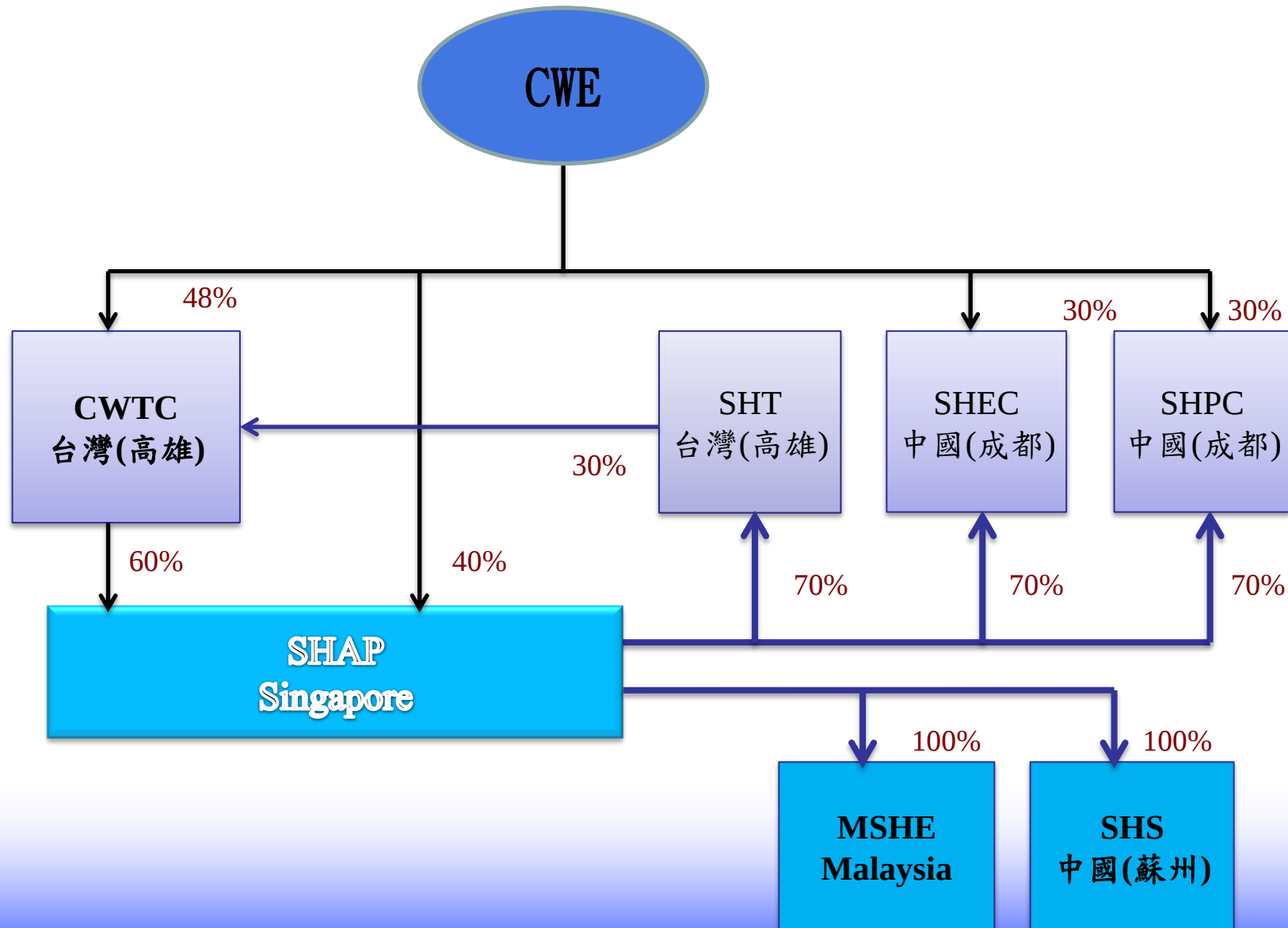
Source : SEMI Industry Research

WORLD WIDE TOP 5 LEADFRAME MARKET SHARE FOR 2015

Supplier	2015 Rank	2015 Revenues \$M	2015 % Market Share
SHM	1	347 M(USD)	11.60%
Mitsui High-tec	2	331 M(USD)	11.00%
SDI	3	290 M(USD)	9.69%
Shinko Electric	4	242 M(USD)	8.09%
ASM Pacific	5	227 M(USD)	7.58%

Source : SEMI Industry Research

MLB專案投資架構圖(PHASE 1)



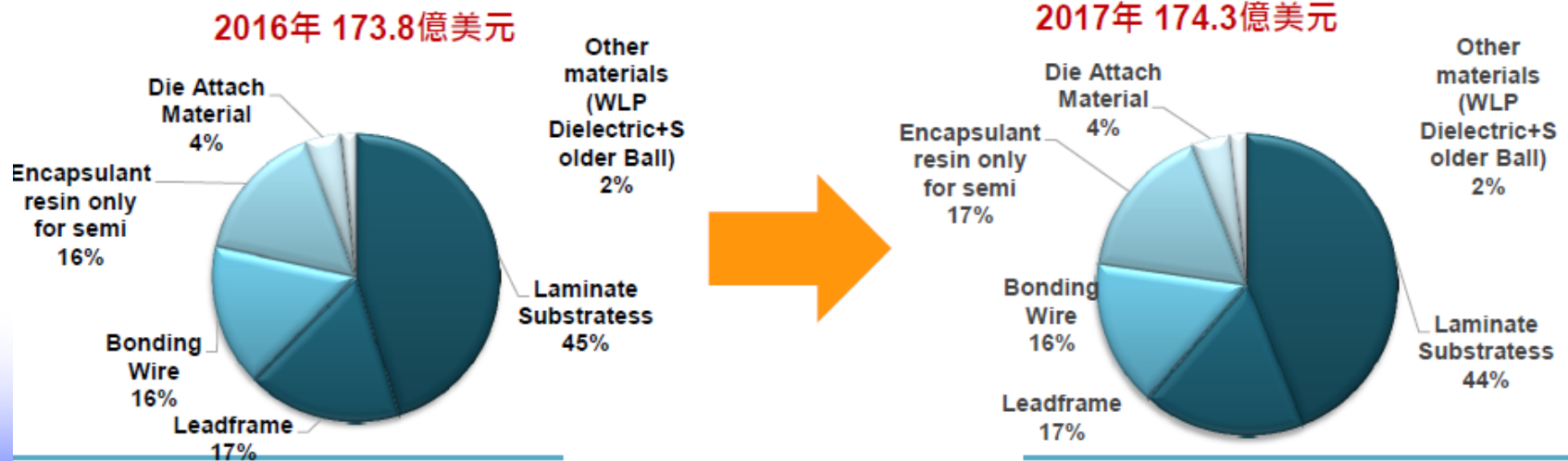
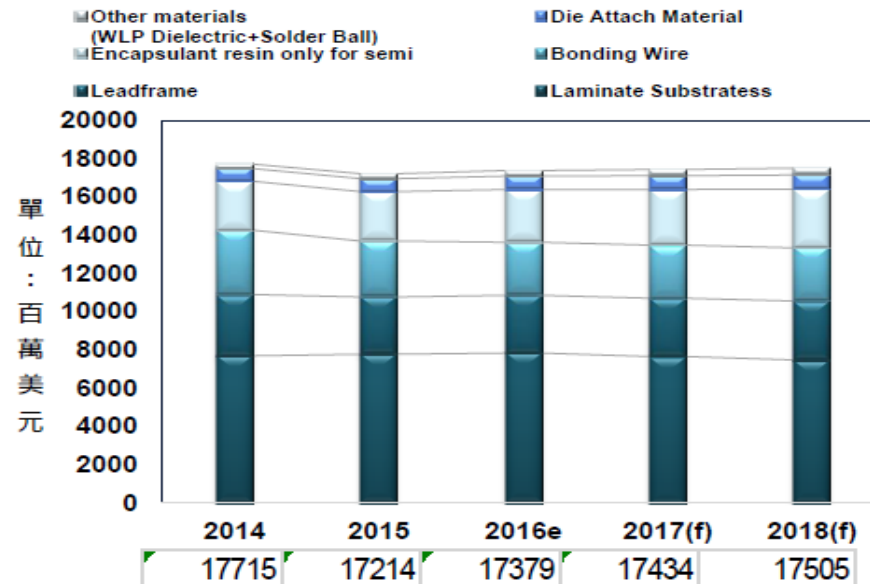
長華、長華科分別出資日幣60億元(折合新台幣約16.8億元)、日幣90億元(折合新台幣約25.2億元)取得SHM(住友金屬礦山SMM子公司)旗下轉投資公司SHAP 40%股權

- 合併營收：待2017年3月31日前完成股權交割，長華科因持有60%SHAP股權，將於股權交割後翌日開始認列100%SHAP營收，而長華合併營收亦將100%認列長華科營收。
- 獲利：長華因直接持有40%SHAP股權，透過持有長華科48%股權，又間接持有28.8%，故最終可以認列68.8%(直間接合計)SHAP獲利。

- 往上一材料支援。
- 往下一完整出海口。

五、全球半導體封裝材料趨勢

全球半導體封裝材料產業現況



GLOBAL ORGANIC SUBSTRATE VOLUME MARKET DEMAND FORECAST

Laminate for IC Package Market Thousands of Square Meters	Actual		Forecast			
	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
Flip Chip BGA/LGA Substrates	2,544	2,637	2,741	2,893	3,045	4.60%
Flip Chip CSP Substrates	801	846	791	757	790	2.00%
Wire Bond PBGA Substrates	1,303	1,303	1,284	1,284	1,269	-2.10%
Wire Bond CSP Substrates	3,186	3,301	3,405	3,559	3,777	3.70%
Total in K Square Meters	7,834	8,087	8,221	8,493	8,881	2.90%
CAGR : Compound annual growth rate			Source : TechSearch International Inc., December 2015			

1. 市調單位預估全球 Organic substrate 的需求量(Km²)從2016~2019 約有2.9%的年複合成長率，顯示Organic substrate 仍處於緩步成長。
2. Flip chip的CAGR以4.6% 最高，以Wire Bond PBGA的-2.1%需求最低，原因是消費性產品對Organic substrate 的要求以細線路、薄型化為主流。這也在Wire Bond CSP substrate CAGR 3.7%得到呼應。
3. 以易華電子所具備之超細線路技術能力足以跨入此高端市場。

GLOBAL LEADFRAME FORECAST

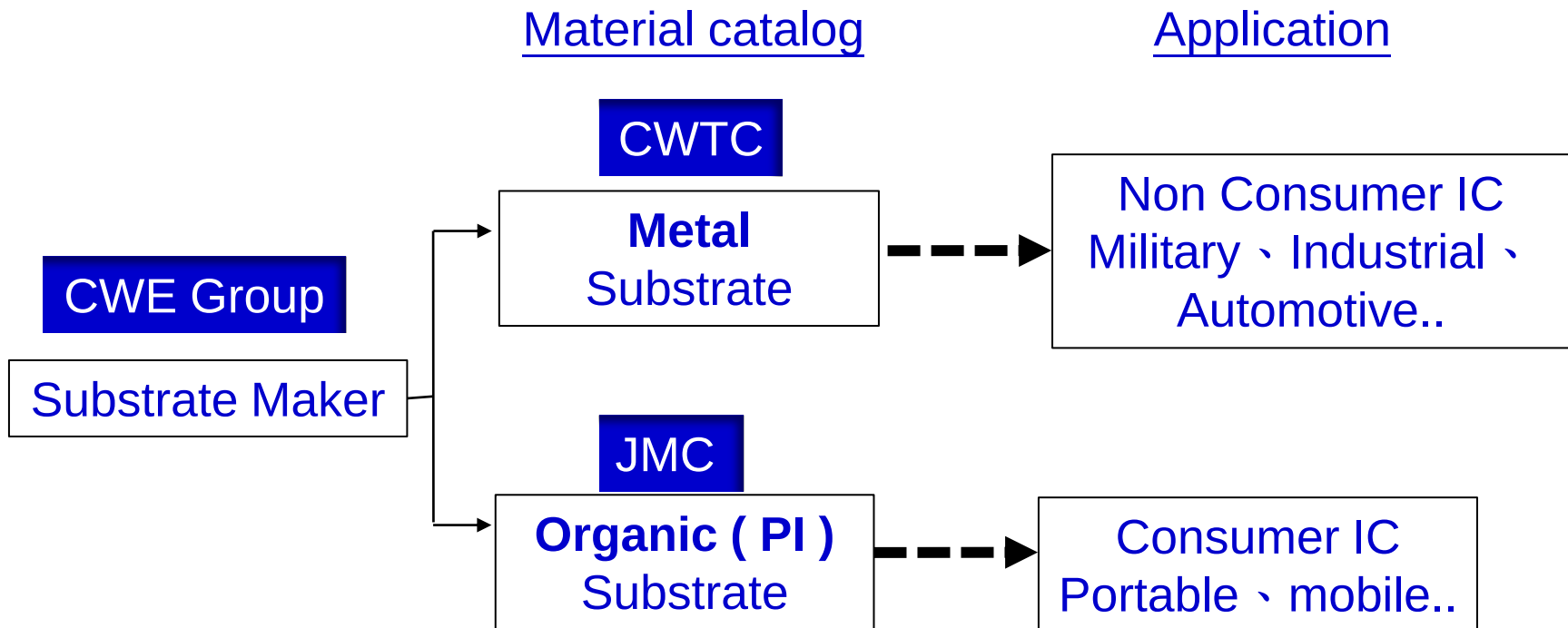
By Year	2015	2016	2017	2018	2019
Total Lead Frame Market (Million USD)	2,991 M	3,001 M	3,037 M	3,042 M	3,020 M
Billion Units	650.8 B	676.6 B	712.2 B	740.6 B	766.5 B

Source : SEMI Industry Research

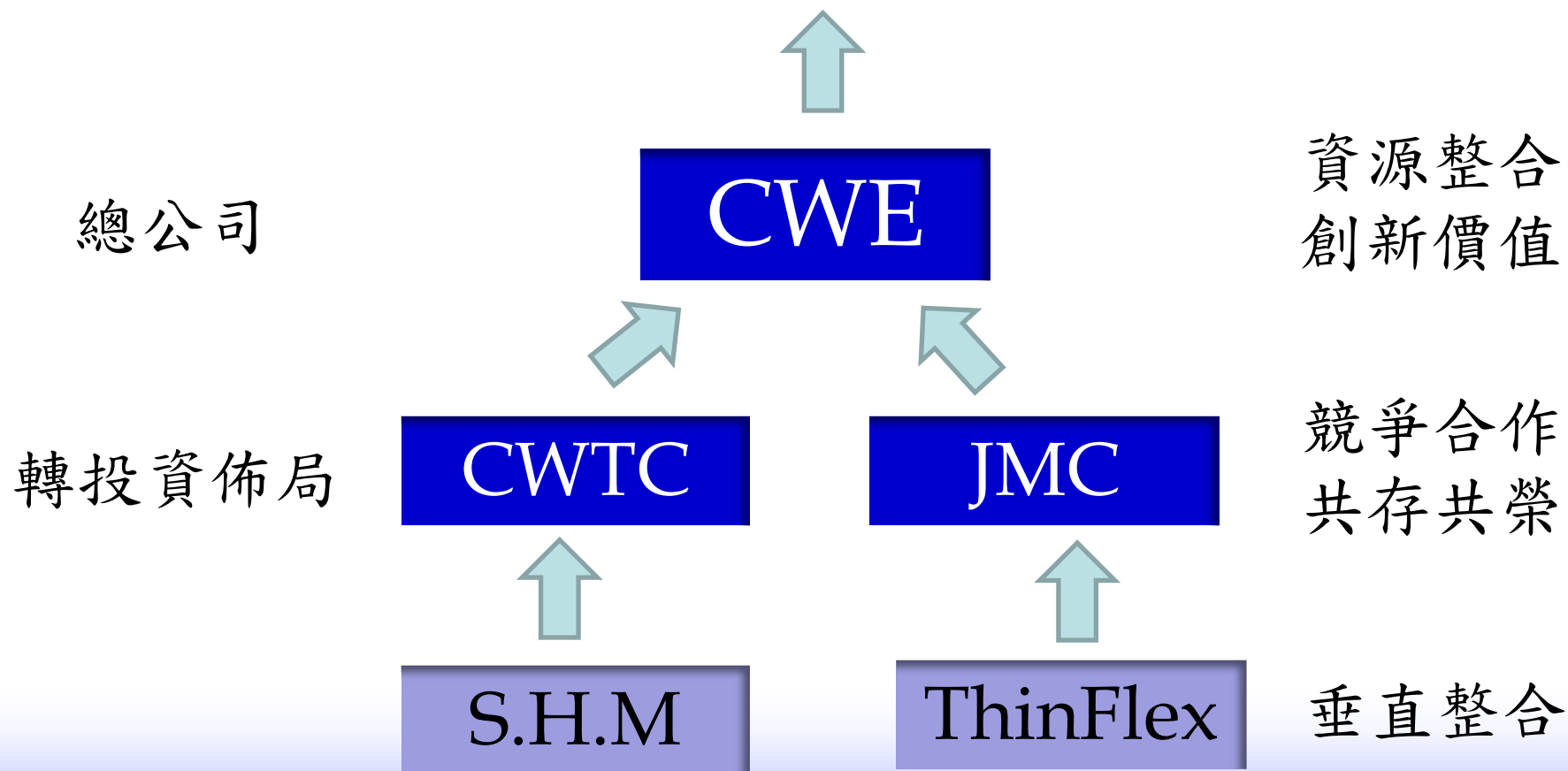
依據SEMI Industry research 的調查，未來三年(2017~2018)
，金屬導線架的整體總量需求將呈現溫和成長。

六、集團之策略佈局與發展規劃

Major IC Package Material : Substrate (Cost around 50%)



晉升為全球IC基板主要供應商之一



Thank You